

证券代码：688484
转债代码：118070

证券简称：南芯科技
转债简称：南芯转债

公告编号：2026-059

上海南芯半导体科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2023 年 3 月首次公开发行股份募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353.00 万股，每股发行价格为人民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056.47 万元，扣除发行费用人民币 16,572.76 万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 237,483.71 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0068 号）。

2、2026 年 6 月发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 5 月 11 日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1150 号），公司获批向不特定对象发行可转换公司债券的注册申

请。公司向不特定对象发行 158,688.10 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,586,881 手（15,868,810 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 1,586,881,000.00 元，扣除不含税的发行费用 13,120,007.59 元，实际募集资金净额为人民币 1,573,760,992.41 元。上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2026]310Z0004 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2023 年首次公开发行股份募集资金实际使用情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 3 月 30 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	2,540,564,700.00
其中：超募资金金额	716,842,301.69
减：直接支付发行费用	165,727,598.31
二、募集资金净额	2,374,837,101.69
减：	
以前年度已使用金额	1,142,752,858.08
本年度使用金额	86,081,783.32
实际使用补充流动性资金	750,606,126.54
现金管理金额	250,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	20,762.57
加：	
募集资金利息收入	45,888,879.89
募集资金专用账户获取的理财收入	15,672,225.86
三、报告期期末募集资金余额	206,936,676.93

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年公开发行可转换债券募集资金实际使用情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2026 年公开发行可转换债券
募集资金到账时间	2026 年 6 月 25 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,586,881,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	10,169,011.97
二、募集资金净额	1,576,711,988.03
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
加：	
募集资金利息收入	-
三、报告期期末募集资金余额	1,576,711,988.03

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海南芯半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。

1、2023 年 3 月首次公开发行股份

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，本公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南

芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》以及公司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。（公告编号：2025-038）。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日，上述三方监管协议均正常履行。

报告期内，公司对已经按照规定使用完毕的募集资金账户进行了注销，详见公司分别于 2025 年 5 月 21 日、2025 年 6 月 10 日和 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-039、2025-042、2026-038）。

2、2026 年 6 月发行可转换公司债券

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，本公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，具体情况详见公司于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。（公告编号：2026-037）。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日，上述三方监管协议均正常履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2023 年首次公开发行股份募集资金具体存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023 年 3 月 30 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海南芯半导体科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801300004414	—	已注销
浙江南芯半	上海浦东发展银行股	9716007880170000	16,534,715.25	使用中

导体有限公司	份有限公司张江科技支行	5811		
浙江南芯半导体有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500005812	186,854,039.82	使用中
上海南芯半导体科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004413	—	已注销
上海南芯半导体科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100004415	—	已注销
上海南芯半导体科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013501588062	—	已注销
浙江南芯半导体有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	571922593810008	3,547,921.86	使用中
上海南芯半导体科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121936870310608	—	已注销
上海南芯半导体科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121936870310855	—	已注销
上海南芯半导体科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865013006606294	—	已注销
上海南芯半导体科技股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03005244551	—	已注销
上海南芯半导体科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海大柏树支行	216380100100371052	—	已注销
上海南芯半导体科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000935063329	—	已注销
	合计	—	206,936,676.93	

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年公开发行可转换债券募集资金具体存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2026 年公开发行可转换债券
------	-----------------

募集资金到账时间			2026 年 6 月 25 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海南芯半导体科技股份有限公司	交通银行股份有限公司 上海张江科技支行	310066865015004567514	—	使用中
上海南芯半导体科技股份有限公司	南京银行股份有限公司 上海分行	0301260000012421	—	使用中
上海南芯半导体科技股份有限公司	中信银行股份有限公司 上海分行	8110201012402126135	1,576,711,988.03	使用中
上海南芯半导体科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行	121936870310018	—	使用中
	合计	—	1,576,711,988.03	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司2023年首次公开发行股份募投项目资金实际使用情况具体详见附表1-1：“募集资金使用情况对照表”。

截至2026年6月30日，公司2026年公开发行可转换公司债券募投项目资金实际使用情况具体详见附表1-2：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2023年3月首次公开发行股份

本报告期内，公司不存在2023年3月首次公开发行股份募投项目先期投入及置换情况。

2、2026年6月发行可转换公司债券

本报告期内，公司不存在2026年6月发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。

2026年8月14日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币133,122,100.26元置换预先投入2026年6月发行可转换公

司债券募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币2,762,316.37元置换已支付发行费用的自筹资金，具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-061）。

截至本公告披露日，2026年6月发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入情况如下：

（1）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为133,122,100.26元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	拟用募集资金 投入金额	自筹资金实际投入金额			占 总 投 资 的 比 例(%)
		建设投资	铺底流动 资金	合计	
智能算力领域 电源管理芯片 研发及产业化 项目	391,090,800.00	23,180,597.85	—	23,180,597.85	5.93%
车载芯片研发 及产业化项目	663,632,400.00	58,922,331.45	—	58,922,331.45	8.88%
工业应用的传 感及控制芯片 研发及产业化 项目	532,157,800.00	51,019,170.96	—	51,019,170.96	9.59%
合计	1,586,881,000.00	133,122,100.26	—	133,122,100.26	8.39%

（2）自筹资金预先支付发行费用情况

公司以自筹资金预先支付发行费用金额为2,762,316.37元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	11,504,762.26	1,415,094.34
审计及评级费用	877,358.49	877,358.49
律师费用	481,184.31	292,505.06
信息披露及发行手续费等费用	256,702.53	177,358.48
合计	13,120,007.59	2,762,316.37

公司2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入资金尚未置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2023年3月首次公开发行股份

为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2025年7月31日召开第二届董事会第七会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2025年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海南芯半导体科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 3 月 30 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
最高不超过人民币 7 亿元（含本数）	购买安全性高、流动性好的投资产品	2025 年 7 月 31 日	2026 年 7 月 30 日	2025 年 7 月 31 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2023 年首次公开发行股份						
募集资金到账时间				2023 年 3 月 30 日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
浙江南芯半导体有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	银行理财产品	15,000.00	2025 年 10 月 13 日	2026 年 1 月 13 日	2026 年 1 月 13 日	-	1.72%	63.75
浙江南芯半导体有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	银行理财产品	10,000.00	2025 年 10 月 13 日	2026 年 4 月 13 日	2026 年 4 月 13 日	-	2.05%	92.50
浙江南芯半导体有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	银行理财产品	5,000.00	2025 年 11 月 26 日	2026 年 1 月 26 日	2026 年 1 月 26 日	-	1.68%	13.79
浙江南芯半导体有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	银行理财产品	3,000.00	2025 年 12 月 5 日	2026 年 2 月 5 日	2026 年 2 月 5 日	-	1.70%	8.41
浙江南芯半导体有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	银行理财产品	18,000.00	2025 年 12 月 15 日	2026 年 6 月 15 日	2026 年 6 月 15 日	-	1.85%	166.50
浙江南芯半导体	上海浦东发展银行股份	结构性存	银行理财产品	15,000.00	2026 年 1 月 19	2026 年 4 月	2026 年 4 月 20	-	1.90%	64.46

体有限公司	有限公司张江科技支行	款			日	20日	日			
浙江南芯半导体有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	银行理财产品	3,000.00	2026年2月12日	2026年3月12日	2026年3月12日	-	1.65%	3.80
浙江南芯半导体有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	银行理财产品	1,000.00	2026年3月20日	2026年6月18日	2026年6月18日	-	1.60%	3.95
浙江南芯半导体有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	银行理财产品	10,000.00	2026年4月20日	2026年7月20日	2026年7月20日	10,000.00	1.85%	41.25
浙江南芯半导体有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	银行理财产品	15,000.00	2026年5月6日	2026年5月29日	2026年5月29日	-	2.20%	19.17
浙江南芯半导体有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	银行理财产品	15,000.00	2026年6月8日	2026年9月8日	2026年9月8日	15,000.00	1.65%	61.03

2、2026年6月发行可转换公司债券

截止至2026年6月30日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日止，不存在募集资金节余的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年2月28日，公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案》，并经2025年3月25日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过同意公司将原募投项目“测试中心建设项目”，变更为“芯片测试产业园建设项目”，实施主体为浙江南芯半导体有限公司，项目总投资144,250.24万元，分两期进行建设，一期投入71,287.30万元，二期投入72,962.94万元。

“测试中心建设项目”变更主要是基于对市场和行业发展趋势的把握，为满足公司发展战略的规划，将“测试中心建设项目”变更成“芯片测试产业园建设项目”，能够为公司研发和生产国产芯片提供基础保障；通过芯片测试研发和生产的一体化，提高公司产品测试技术能力；能够更有效地控制产品质量，提高生产效率，降低不良率和售后服务成本，提升公司产品质量管理水平；同时自主可控的测试产线有利于保障公司产品稳定供应，有利于公司降低产品测试成本；能够提升公司的核心竞争力，支持公司经营规模的提升，尤其是车规业务规模的发展，符合公司长期发展战略。因此，公司将原“测试中心建设项目”，变更为“芯片测试产业园建设项目”，实际变更募集资金27,323.64万元及其孳息1,036.21万元用于“芯片测试产业园建设项目”，同时实际使用剩余超募资金29,684.23万元及其孳息1,687.01万元增加投资额，合计实际使用募集资金57,007.87万元及其孳息2,723.22万元用于“芯片测试产业园建设项目”一期投资。其余所需资金由公司自有资金、自筹资金补足。变更募集资金金额为57,007.87万元，占募集资金总额的比例24.00%。

变更募投项目的资金使用情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。本报告期内，因公司财务人员误操作，误将非募集资金账户的结汇款汇入募集资金专户，公司及时发现并转出该款项；该笔操作未影响募集资金存放与使用，后续公司将加强日常管理，避免类似情况发生。除上述事项外，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实

际使用情况。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司存在两笔募集资金，本专项报告对 2023 年 3 月首次公开发行人股份募集资金、2026 年 6 月发行可转换公司债券募集资金的存放及使用情况分别说明，情况详见“附表 1-1”和“附表 1-2”。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附表 1-1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023 年 3 月 30 日										
本年度投入募集资金总额			8,608.18										
已累计投入募集资金总额			197,944.08										
变更用途的募集资金总额			57,007.87										
变更用途的募集资金总额比例			24%										
承诺投资项目和超募资金投向	募 投 项 目 性质	已 变 更 项目,含 部分 变 更 (如 有)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调整后投资 总额	截至期末承 诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计 投入金额(2)	截至期末累 计 投入金额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期(具体 到月份)	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
高性能充电管 理和电池管理 芯片研发和产 业化项目	研发 项目	否	45,686.45	45,686.45	45,686.45	-	46,632.71	946.26	102.07	2025 年 12 月	不 适 用	不 适 用	否
高集成度 AC- DC 芯片组研 发和产业化项 目	研发 项目	否	22,717.78	22,717.78	22,717.78	-	23,320.11	602.33	102.65	2025 年 12 月	不 适 用	不 适 用	否

汽车电子芯片研发和产业化项目	研发项目	否	33,484.43	33,484.43	33,484.43	-	34,403.28	918.85	102.74	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
测试中心建设项目	研发项目	是	30,910.82	3,587.18	3,587.18	-	3,587.18	-	100.00	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
芯片测试产业园建设项目	研发项目	是	-	27,323.64	27,323.64	8,608.18	14,940.19	-12,383.45	54.68	2031 年 2 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	研发项目	否	33,000.00	33,000.00	33,000.00	-	33,060.61	60.61	100.18	不适用	不适用	不适用	否
承诺项目小计			165,799.48	165,799.48	165,799.48	8,608.18	155,944.08	-9,855.40	94.06	-	-	-	-
超募资金投向													
超募资金永久补充流动资金	研发项目	否	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金用于芯片测试产业园建设项目一期	研发项目	是	29,684.23	-	29,684.23	-	-	-29,684.23	-	2031 年 2 月	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-		71,684.23	-	71,684.23	-	42,000.00	-29,684.23	-	-	-	-	-
合计			237,483.71	237,483.71	237,483.71	8,608.18	197,944.08	-39,539.63	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金实际使用情况（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表 1-2:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年公开发行可转换债券										
募集资金到账日期			2026 年 6 月 25 日										
本年度投入募集资金总额			-										
已累计投入募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目	研发项目	否	37,797.07	37,797.07	37,797.07	-	-	-37,797.07	-	2029 年 12 月	不适用	不适用	否
车载芯片研发及产业化项目	研发项目	否	66,363.25	66,363.25	66,363.25	-	-	-66,363.25	-	2029 年 12 月	不适用	不适用	否
工业应用的传感及控制芯片	研发项目	否	53,215.78	53,215.78	53,215.78	-	-	-53,215.78	-	2029 年 12	不适用	不适用	否

研发及产业化项目										月			
合计			157,376.10	157,376.10	157,376.10	-	-	-157,376.10	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

注 1：本报告中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2023 年 3 月												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
芯片测试产业园建设项目	测试中心建设项目	研发项目	浙江南芯半导体有限公司	境内	57,007.87	57,007.87	8,608.18	14,940.19	26.21	2031 年 2 月	不适用	不适用	不适用	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 25 日
合计					57,007.87	57,007.87	8,608.18	14,940.19	26.21	-	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用